

半导体

证券研究报告

2023年02月27日

23Q1 库存持续去化，基本面或加速触底

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

潘暕

分析师

SAC 执业证书编号: S1110517070005
panjian@tfzq.com

程如莹

分析师

SAC 执业证书编号: S1110521110002
chengruiying@tfzq.com

骆奕扬

分析师

SAC 执业证书编号: S1110521050001
luoyiyang@tfzq.com

行业走势图



资料来源: 贝格数据

相关报告

- 1 《半导体-行业研究周报:22年12月国产半导体设备中标数同比+185%,关注 ChatGPT 领域及周期复苏》 2023-02-19
- 2 《半导体-行业研究周报:海外半导体年报解读,2023年周期有望见底》 2023-02-15
- 3 《半导体-行业研究周报:IC设计新品逐步发布,有望加速复苏》 2023-01-09

本周行情概览:

本周半导体行情跑输部分主要指数。本周申万半导体行业指数下跌 0.13%，同期创业板指数下跌 0.83%，上证综指上涨 1.34%，深证综指上涨 0.61%，中小板指上涨 0.45%，万得全 A 上涨 0.98%。半导体行业指数跑输部分主要指数。半导体细分板块中，半导体制造板块本周下跌 1.1%，半导体设备板块本周下跌 0.5%，分立器件板块本周下跌 1.3%，半导体材料板块本周上涨 0.6%，IC 设计板块本周下跌 1.3%，封测板块本周下跌 0.02%，其他板块本周下跌 1.0%。

IC 设计：供应端改善+需求逐步复苏，基本面复苏可期。 存储芯片方面，华邦电/旺宏/南亚科实现营收 48.9/22.1/22.5 亿台币，同比变动-44%/-41%/-67%。模拟芯片方面，矽力杰/致新实现营收 10.3 亿台币与 5.6 亿台币，同比变动-46%/-31%。主控芯片方面，联发科/瑞昱实现营收 224/55 亿台币，同比变动-49%/-46%。高速传输芯片方面，谱瑞/信骅/威锋电子 1 月实现营收 11.5/2.2/1.1 亿台币，同比下降 41%/43%/68%。MCU 方面，盛群/新唐/松翰 1 月实现营收 2.5/23.4/1.6 亿台币，同比下降 61%/32%/52%。射频芯片方面，稳懋/宏捷科/立积实现营收 8.7/1.2/2.2 亿台币，同比变动-55%/-52%/-20%。显示驱动芯片方面，联咏/敦泰/聚积实现营收 72.2/7.6/1.4 亿台币，同比变动-41%/-45%/-41%。

功率器件：海外大厂价格维稳，新能源汽车 23 年同比维持高增长。 功率器件厂商方面，茂矽/杰力/富鼎/强茂实现营收/1.4/1.2/2.0/8.5 亿台币，同比下降 21%/51%/48%/36%。

代工封测：产能释放或降低代工成本，IC 设计盈利能力有望逐步优化。 晶圆代工方面，台积电/联电/力积电实现营收 2001/196/39.3 亿台币，同比变动 16%/-4%/-43%。封装测试方面，日月光/京元电/力成实现营收 451/26/50 亿台币，同比下降 7%/17%/31%。

建议关注：

- 1) **半导体设计：**澜起科技/聚辰股份/晶晨股份/江波龙（天风计算机联合覆盖）/帝奥微/纳芯微/圣邦股份/中颖电子/斯达半导/宏微科技/东微半导/瑞芯微/思瑞浦/扬杰科技/新洁能/兆易创新/韦尔股份/思特威/艾为电子/富瀚微/恒玄科技/乐鑫科技/全志科技/卓胜微/晶丰明源/声光电科/紫光国微/复旦微电/龙芯中科/海光信息（天风计算机覆盖）/普冉股份/北京君正/东芯股份；
- 2) **半导体材料设备零部件：**正帆科技（天风机械联合覆盖）/江丰电子/北方华创/新莱应材（天风机械覆盖）/华亚智能/神工股份/英杰电气/富创精密/明志科技/汉钟精机（天风机械覆盖）/国机精工（天风机械覆盖）；雅克科技/沪硅产业/华峰测控（天风机械覆盖）/上海新阳/中微公司/精测电子（天风机械联合覆盖）/长川科技（天风机械覆盖）/鼎龙股份（天风化工联合覆盖）/安集科技/拓荆科技（天风机械联合覆盖）/盛美上海/多氟多/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/金宏气体（天风化工覆盖）/凯美特气/杭氧股份（天风机械覆盖）/和远气体；
- 3) **IDM 代工封测：**时代电气/士兰微/扬杰科技/闻泰科技/三安光电；华虹半导体（天风海外组联合覆盖）/中芯国际/长电科技/通富微电；
- 4) **卫星产业链：**声光电科/复旦微电/铖昌科技/振芯科技/北斗星通

风险提示：疫情继续恶化；上游供给不足；科研进度不及预期；需求不及预期

内容目录

1. 每周谈：23Q1 库存持续去化，基本面或加速触底.....	3
1.1. 中国台湾半导体企业 1 月营收数据	3
1.2. IC 设计：供应端改善+需求逐步复苏，基本面复苏可期	4
1.3. 功率器件：海外大厂价格维稳，新能源汽车 23 年同比维持高增长.....	8
2. 本周半导体行情回顾.....	9
3. 本周重点公司公告 半导体公司公告.....	10
4. 本周半导体重点新闻.....	11
5. 风险提示：	11

1. 每周谈：23Q1 库存持续去化，基本面或加速触底

1.1. 中国台湾半导体企业 1 月营收数据

1 月营收受节假日影响，叠加需求疲软+去库存导致大部分企业同比/环比大幅下跌。存储芯片方面，华邦电/旺宏/南亚科实现营收 48.9/22.1/22.5 亿台币，同比变动-44%/-41%/-67%，环比均有下跌。联发科 2023M01 实现营收 224 亿台币，同比变动-49%，环比下跌 42%；瑞昱则实现营收 54.9 亿台币，同比下跌 46%。MCU 方面，盛群/新唐/松翰 1 月分别实现营收 2.51/23.4/1.62 亿台币，同比下跌 61%/32%/52%。高速传输芯片方面，厂商业绩下滑严重，谱瑞与威锋电子 1 月分别实现营收 11.5 亿台币与 1.11 亿台币，同比下跌 41%与 68%。显示驱动芯片方面，联咏/敦泰/聚积 1 月实现营收 72.2/7.58/1.44 亿台币，同比下跌 41%/45%/41%。模拟芯片方面，矽力与致新 1 月分别实现营收 10.3 亿台币与 5.6 亿台币，同比下跌 46%与 31%。射频芯片方面，受智能手机行情下行影响，手机 PA 需求疲弱：稳懋/宏捷科/立积分别实现营收 8.73/1.19/2.2 亿台币，同比下跌 55%/52%/20%。功率器件方面，2023M01 茂硅/杰力/富鼎/强茂分别实现营收 1.35/1.19/1.96/8.49 亿台币，同比下跌 21%/51%/48%/36%。碳化硅相关厂商 2023M01 汉磊与嘉晶分别实现营收 6.07 亿台币与 3.81 亿台币，同比下跌 12%与 21%。晶圆代工方面，台积电/联电/力积电 1 月分别实现营收 2001/196/39.3 亿台币，同比变动 16%/-4%/-43%。封测方面，日月光/京元电/力成 1 月分别实现营收 451/25.6/50 亿台币，同比下跌 7%/17%/31%。

表 1：中国台湾半导体企业月度数据情况

公司	22M12 营收 (亿台币)	23M01 营收 (亿台币)	23M01 营收月增 MoM %	23M01 营收年增 YoY %
华邦电	64.8	48.9	-25%	-44%
旺宏	25.8	22.1	-14%	-41%
南亚科	24	22.5	-6%	-67%
联发科	387	224	-42%	-49%
瑞昱	63.8	54.9	-14%	-46%
盛群	3.47	2.51	-28%	-61%
新唐	30	23.4	-22%	-32%
松翰	1.81	1.62	-10%	-52%
谱瑞	9.42	11.5	-22%	-41%
信骅	3.91	2.2	-44%	-43%
威锋电子	1.32	1.11	-16%	-68%
联咏	77.7	72.2	-7%	-41%
敦泰	11.3	7.58	-33%	-45%
聚积	1.42	1.44	-1%	-41%
矽力	14.9	10.3	-31%	-46%
致新	5.55	5.6	-1%	-31%
稳懋	10.9	8.73	-20%	-55%
宏捷科	1.26	1.19	-6%	-52%
立积	2.31	2.2	-5%	-20%
茂硅	1.51	1.35	-11%	-21%
杰力	1.2	1.19	-1%	-51%
富鼎	2.14	1.96	-8%	-48%
强茂	9.03	8.49	-6%	-36%
汉磊	6.78	6.07	-10%	-12%
嘉晶	4.47	3.81	-15%	-21%
台积电	1926	2001	4%	16%
联电	209	196	-6%	-4%
力积电	41	39.3	-4%	-43%
日月光	531	451	-15%	-7%
京元电	29.3	25.6	-13%	-17%

力成

57.8

50

-13%

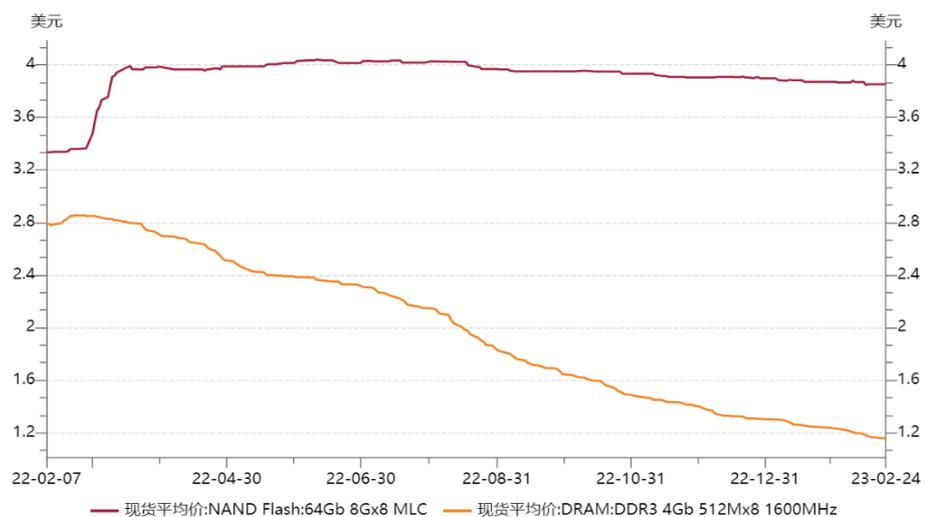
-31%

资料来源: Goodinfo, 天风证券研究所

1.2. IC 设计：供应端改善+需求逐步复苏，基本面复苏可期

存储芯片：减产+需求稳步复苏，价格跌幅有望逐季度缩窄。2023 年 1 月，台系存储芯片厂商业绩表现不佳。其中主营业务为 NOR/NAND Flash 的华邦电与旺宏分别实现业绩 48.9 亿台币与 22.1 亿台币，同比变动-44%与-41%；主营业务为 DRAM 的南亚科实现营收 22.5 亿台币，同比下跌 67%。下游需求降低，市场持续低迷，今年一季度为半导体行业销售淡季。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计 2023 年降幅最大的细分类别为市场规模占比两成多的存储芯片，预计 2023 年存储芯片市场规模同比减少 17%至 1120 亿美元，1) **NOR Flash 方面**，根据华邦电数据，2022 年供给端第四季有所减产，个人电脑需求复苏缓慢，2023 年第一季或为谷底，第二季后有望开始复苏，车用、工业用、5G 基地台、伺服器等高容量 NOR Flash 需求稳健。个人电脑市场已有逐渐复苏迹象，客户端已经开始拉货，生产链仍有库存需要去化，预期 2023 年前三季需求将逐季成长。2022 年第四季 NOR Flash 价格平稳下滑，减产对毛利率冲击较大，第一季度 NOR Flash 价格调整较多，预估是价格谷底。2) **NAND Flash 方面**：根据 TrendForce 集邦咨询数据，2022 年第四季度 NAND 闪存的平均合同价格比上一季度下降约 28%；产品价格今年上半年可能会继续下降，按季度计算，价格预计第一季度下降 10%，第二季度下降 3%，NAND 闪存价格可能会从随着供应商的积极削减供应而在 2023 年下半年开始反弹。Client SSD 方面，由于 2023 年笔电需求仍弱，笔电品牌备货保守，加上 2023 年 Client SSD 需求位元成长持续放缓，且减产效益尚未发酵，供过于求情形或将持续。不过 TrendForce 集邦咨询目前观察，部分减产供应商力守价格的策略已奏效，第一季 Client SSD 价格跌幅获控制，收敛至 10~15%。Enterprise SSD 方面，由于消费产品需求骤减，导致供应商 Enterprise SSD 库存水位积压，2022 年第四季度合约价格跌幅扩大至 23~28%。未来几年随着 AI 服务兴起，在高速存取及运算需求推升的情况下，Enterprise SSD 未来订单需求或将优于其他产品。TrendForce 集邦咨询预估，Enterprise SSD 需求位元可望于 2025 年成为 NAND Flash 最大产品应用 3) **DRAM 方面**：由于消费需求疲软，库存压力持续，三星（Samsung）在竞价策略下库存略降，为避免 DRAM 产品价格再次大幅下降，诸如美光（Micron）等多家供应商已开始减产，据 TrendForce 集邦咨询预计，2023 年第一季度 DRAM 价格跌幅可能因此收敛至 13%~18%，但仍不见下行周期的终点。其中 PC 及 Server DRAM 跌幅仍是近两成左右；Mobile DRAM 在盈利空间最为压缩的情况下，是跌幅收敛明显的品相。

图 1：NAND Flash 4Gx8 MLC 与 DDR3 512Mx8 1600MHz 现货平均价走势（美元）



资料来源: Wind, 天风证券研究所

模拟芯片：全球模拟芯片市场规模稳步增长趋势不变，海外大厂建设投产持续进行。2023M01，电源管理芯片厂商矽力杰与致新分别实现营收 10.3 亿台币与 5.6 亿台币，同比下降 46%与 31%。然而根据 WSTS 预测数据，预计 2023 年模拟芯片市场规模同比增速有望达到 10.2%达到 527.11 亿美元。据 Digitimes 报道，德州仪器（TI）将在 2022 年底至

2023 年初之间有两个新的 300mm 晶圆厂投产，额外的产量有望满足来自汽车电子市场的芯片需求，这被视为模拟芯片供应商的下一个主要增长动力。德州仪器 (TI) 于 2 月 15 日宣布计划在犹他州李海建造其下一个 300 毫米半导体晶圆厂。新工厂预计将于 2023 年下半年开始建设，最早将于 2026 年投产。

表 2: 截至 23Q1 海外模拟芯片大厂产品的货期与价格变化趋势 (最近更新时间: 2023 年 2 月 17 日)

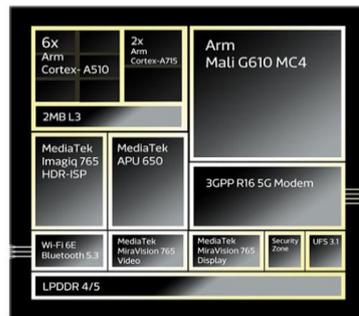
厂商	产品类别	23Q1 货期 (周)	货期趋势	价格趋势
Infineon	汽车模拟和电源	45-52	维稳	上涨
NXP	汽车模拟和电源	45-52	维稳	上涨
Onsemi	多源模拟/电源	35-42	维稳	维稳
ST	多源模拟/电源	40-50	维稳	维稳
	汽车模拟和电源	40-52	维稳	维稳

资料来源: 富昌电子官网, 天风证券研究所

主控芯片: 需求有望逐步触底, 大厂发布新产品站稳高端市场。联发科与瑞昱 1 月分别实现营收 244 亿台币与 54.9 亿台币, 同比下降 49%与 46%。根据联发科公告, 预计搭载天玑 7200 移动平台的智能手机将于 2023 年第一季度上市, 天玑 7200 采用与天玑 9200 相同的台积电第二代 4nm 制程, 八核 CPU 架构, 包括 2 个主频为 2.8GHz 的 Arm Cortex-A715 核心, 以及 6 个 Cortex-A510 核心, 集成 AI 处理器 APU 650, 提升 AI 运算效率同时还拥有低功耗特性。此外联发科将于 2023 消费电子展 (CES2023) 展示最新的 Genio 700 应用, 采用高效能 6 奈米制程, 八核 CPU 包括 2 个主频为 2.2GHz 的 Arm Cortex-A78 核心与 6 个主频为 2.0GHz 的 Cortex-A55 核心, 整合的 AI 加速器可提供 4TOPs 强劲性能, 同时支持 4K 60Hz 和 FHD 60Hz 显示, 整合 ISP 影像讯号处理器, 提供更出色的影像画质, 满足智能装置对高速 AI 算力和物联网质量的需求, 进一步丰富了联发科技的智能物联网产品组合。

图 2: 联发科天玑 7200 平台参数与架构

天玑 7200 基于旗舰级的台积电第二代 4nm 制程打造, 八核 CPU 架构可以轻松应对多任务处理并充分发挥峰值性能, 平台的高能效特性有助于终端实现更长时间续航。

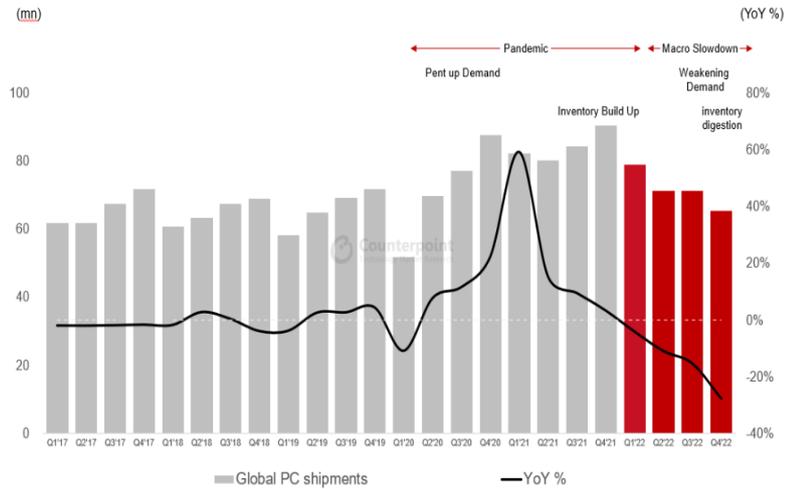


- 台积电第二代 4nm 制程
- CPU 采用 2 个第二代 Armv9 架构 Cortex-A715 核心, 6 个 Cortex-A510 核心
- Arm Mali-G610 MC4 GPU
- HyperEngine 5.0 游戏引擎
- 高效能 AI 处理器 APU 650

资料来源: 联发科官网, 天风证券研究所

高速传输芯片: 服务器与 PC 需求疲软, 22Q4 出货量同比下滑。高速传输芯片厂商中, 谱瑞、信骅与威锋电子 1 月分别实现营收 11.5 亿台币、2.2 亿台币与 1.1 亿台币, 同比下降 41%、43%与 68%, 主营业务为 PCIe Retimer 的谱瑞业绩表现亮眼, 环比增长 23%, 但信骅与威锋电子环比下降 44%与 16%。根据国际电子商情报告数据显示, 2022 年第四季度全球服务器出货量环比下降 7.1%, 同比下降 4.3%, 原因是中国数据中心运营商和服务品牌出货势头低迷, 而 Meta 和谷歌等云服务提供商的需求疲软; 在全球经济不景气的情况下, 2023 年第一季度美国和中国的大型数据中心运营商或进一步削减服务器采购, 而戴尔和 HPE 等服务器品牌的需求也将放缓。PC 方面, 根据 Counterpoint Research 的数据, 2022 年第四季度全球 PC 出货量同比下降 27.8%, 全球 PC 需求疲软, 出货量连续四个季度同比下降。

图 3: 全球 PC 市场出货量 (百万台) 与同比增速



资料来源：Counterpoint Research，国际电子商情，天风证券研究所

MCU：产品去库存状态延续，市场价格维持稳定。 MCU 厂商盛群/新唐/松翰 1 月实现营业收入 2.5/23.4/1.6 亿台币，同比下跌 61%/32%/52%。根据盛群总经理高国栋表示，预计 2023 年第一季度或为景气低谷，当前库存大约 5~6 个月，预估 2023 年第 3 季库有望回到正常水位；目前有出现部分急单，例如血氧仪等产品，随着 32 位元、RF 射频、电源、直流无刷马达（BLDC）等新品及新方案的推出，预计 2023 年下半年表现将比上半年更好，全年同比增速维稳。根据富昌电子数据，海外 MCU 厂商当前大部分产品货期维稳或缩短，汽车 MCU 货期部份紧缺，价格趋势维稳或上涨。

表 3：2023Q1 海外龙头 MCU 厂商不同产品的货期与价格变化趋势

厂商	产品类别	货期（周）	货期趋势	价格趋势
Infineon + Cypress	8 位 MCU	45-52	维稳	维稳
	32 位 MCU	45	延长	维稳
	汽车 MCU	32-45	维稳	维稳
Infineon	汽车 MCU	紧缺	维稳	维稳
Microchip	8 位 MCU	36-52+	缩短	上涨
	32 位 MCU	36-52+	缩短	上涨
NXP	8 位 MCU	35-52	缩短	维稳
	32 位 MCU	26-52	缩短	维稳
	汽车 MCU	35-52	维稳	维稳
Renesas	8 位 MCU	40	缩短	上涨
	32 位 MCU	40	缩短	上涨
	汽车 MCU	45	维稳	维稳
ST	8 位 MCU	48	缩短	维稳
	32 位 MCU	20-26	缩短	维稳
	汽车 MCU	40-52	维稳	维稳

资料来源：富昌电子官网，天风证券研究所

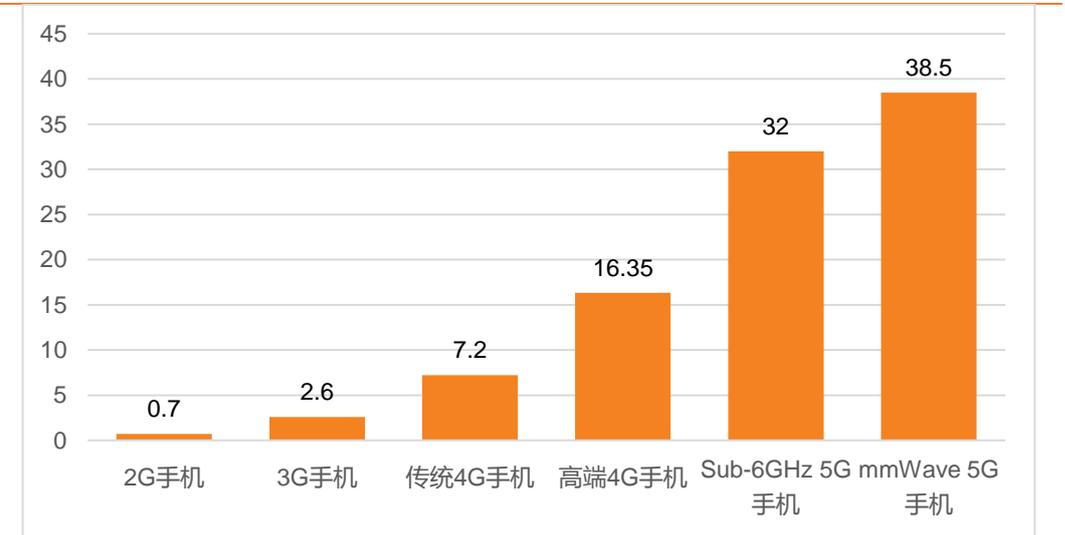
射频芯片：手机库存仍处在调整阶段，5G 带动射频前端市场需求趋势不变。 1 月份相关厂商表现不佳，砷化镓代工厂商稳懋与宏捷科 1 月分别实现营业收入 8.7 亿台币与 1.2 亿台币，同比减少 55%与 52%；射频前端厂商立积 1 月实现营业收入 2.2 亿台币，同比减少 20%。根据 Wind 数据，2022 年 12 月中国智能手机产量约 1.05 亿台，同比下降 22%，相较于 2022 年 11 月同比跌幅扩大，但 12 月环比微幅增长。5G 时代的到来使得集成度高的射频前端更受市场关注，随着每部手机所消耗的射频器件数量增多，射频前端的需求将持续性增长。与 2G、3G、4G 手机相比，5G 手机中单机射频芯片价值含量也有了显著的提升。根据 Yole Développement 统计，2G 手机单机射频芯片总价值为 0.7 美元，到 5G 手机单机射频芯片总价值达 32-38.5 美元，两者间的射频芯片价值相差 45-55 倍。同时，5G 手机出货量也有提升，中国信息通信研究院预测 2023 年，全球 5G 手机出货量将超 7 亿部，占全球智能手机市场的 50%。

图 4：中国智能手机产量（万台）



资料来源：Wind，天风证券研究所

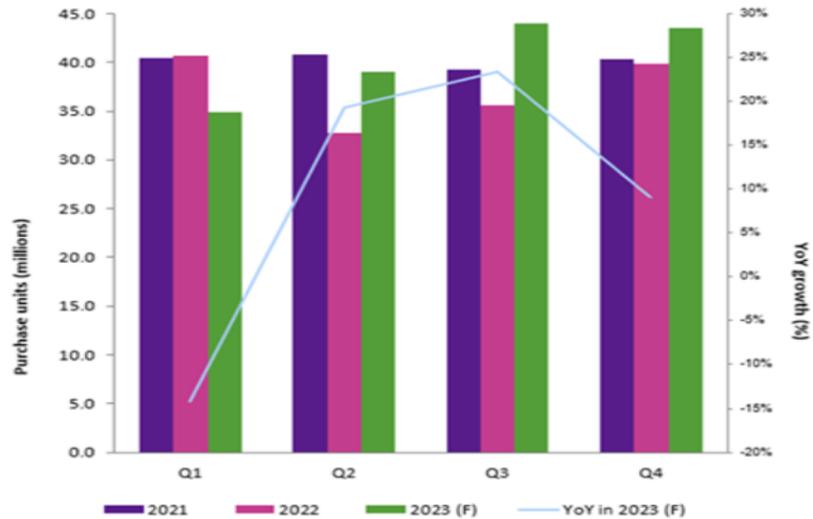
图 5：平均每部手机中射频芯片价值（美元）



资料来源：Yole Développement，国际电子商情，天风证券研究所

显示驱动芯片：TV 面板订单需求或加速触底，市场有望逐步复苏。显示驱动芯片厂商中，联咏、敦泰与聚积 1 月分别实现营收 72.2 亿台币、7.6 亿台币与 1.4 亿台币，同比下跌 41%、45%与 41%。根据 Omdia 消息，韩国和中国电视制造商液晶电视面板订单需求复苏即将到来，2023 年第二季度该市场有望实现 19% 的年同比强劲反弹，同时预计其采购量将达到 1.614 亿片或年同比增长 8%，50 英寸及以上尺寸屏幕的出货量将更为显著。如果 2023 年的采购计划切实推行，则市场将恢复到 2020 年采购量的峰值水平，比过去四年平均水平高出 3%。根据 CEVA（全球领先的无线连接和智能感知技术及共创解决方案的授权许可厂商）公告，2022 年 12 月已授权予领先的无晶圆厂芯片设计公司联咏科技，让其在瞄准监控、零售、智能城市、交通等领域的最新一代 NT98530 多传感器 IP 摄像头 SoC 中部署使用 CEVA SensPro2 Sensor Hub DSP 架构系列的 SP500 DSP。集成式 SensPro2 是 CEVA 最新一代 DSP，配合其全面优化 SDK，与其前代产品相比，可将计算机视觉 DSP 性能提高 6 倍，AI 推理性能提高 2 倍，并将功耗降低了 20%，从而确保联咏科技的最新 SoC 具有充分的性能来支持最复杂的计算机视觉算法和神经网络推理。

图 6：2021~2023 年 E 中韩前 5 大电视制造商液晶电视面板采购量（百万）



资料来源：Omdia，十轮网，天风证券研究所

1.3. 功率器件：海外大厂价格维稳，新能源汽车 23 年同比维持高增长

功率器件消费赛道需求较弱，下半年市场有望回暖。功率器件厂商方面，茂矽/杰力/富鼎/强茂 1 月实现营收 1.4/1.2/2.0/8.5 亿台币，同比下跌 21%/51%/48%/36%。碳化硅厂商方面，汉磊与嘉晶 1 月分别实现营收 6.1 亿台币与 3.8 亿台币，同比下跌 12%与 21%。根据富昌电子数据，英飞凌、安森美、ST、罗姆等海外大厂 MOSFET、IGBT 货期趋势与价格趋势大部分维稳。

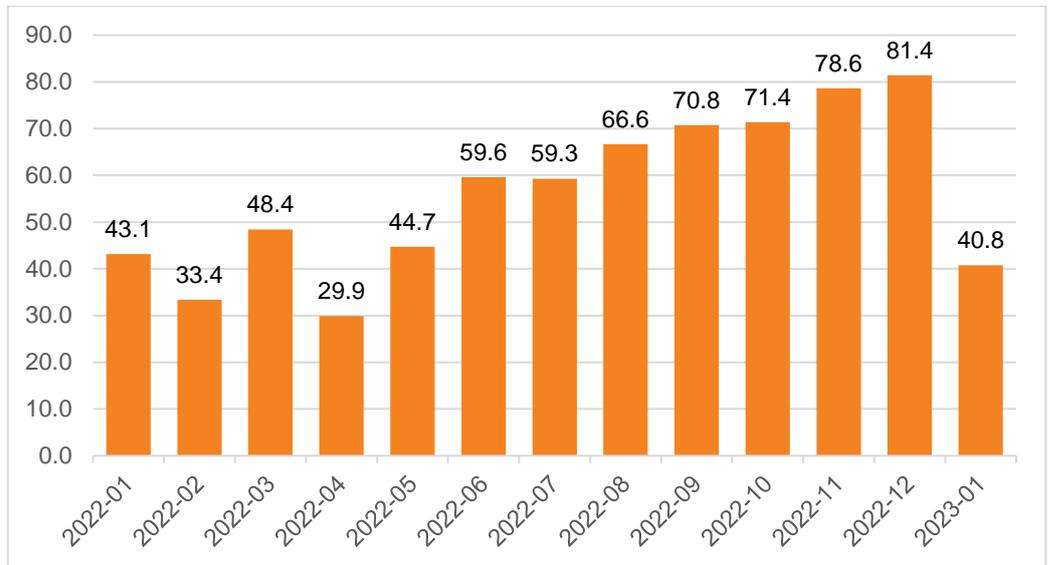
表 4：2023Q1 外龙头功率器件厂商不同产品的货期与价格变化趋势（最近更新时间：2023 年 2 月 17 日）

厂商	产品类别	货期（周）	货期趋势	价格趋势
Infineon	低压 MOSFET	26-54	缩短	维稳
	高压 MOSFET	50-54	维稳	维稳
	宽禁带 MOSFET	42-52	维稳	维稳
	IGBT	39-50	维稳	维稳
Onsemi	低压 MOSFET	36-52	缩短	上涨
	高压 MOSFET	36-52	维稳	上涨
	宽禁带 MOSFET	42-52	维稳	维稳
Microchip	宽禁带 MOSFET	24-28	维稳	维稳
Rohm	高压 MOSFET	42-52	维稳	维稳
	宽禁带 MOSFET	42-52	维稳	维稳
	肖特基二极管	20-52	维稳	维稳
ST	低压 MOSFET	50-54	维稳	维稳
	高压 MOSFET	47-52	维稳	维稳
	宽禁带 MOSFET	42-52	维稳	维稳
	IGBT	47-52	维稳	维稳

资料来源：富昌电子官网，天风证券研究所

2023 年 1 月受春节假日影响，新能源汽车产销量下滑，放眼全年市场稳中有进。根据中国汽车工业协会预测，2023 年，我国新能源汽车总销量为 900 万辆，同比增长 35%，而 2023 年的新能源汽车渗透率预计达到 32.6%。2022 年，我国新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，分别同比增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。中国汽车工业协会发布的最新数据显示，1 月，新能源汽车产销分别达到 42.5 万辆和 40.8 万辆，环比分别下降 46.6%和 49.9%，同比分别下降 6.9%和 6.3%，市场占有率为 24.7%。除去春节假期因素外，新能源汽车补贴退出也是产销量走低的重要原因。考虑到去年底的高基数，当前的市场滑坡也在预期之中，2023 全年的新能源汽车市场仍可期。

图 7：中国新能源汽车销量（万辆）



资料来源: wind, 天风证券研究所

2. 本周半导体行情回顾

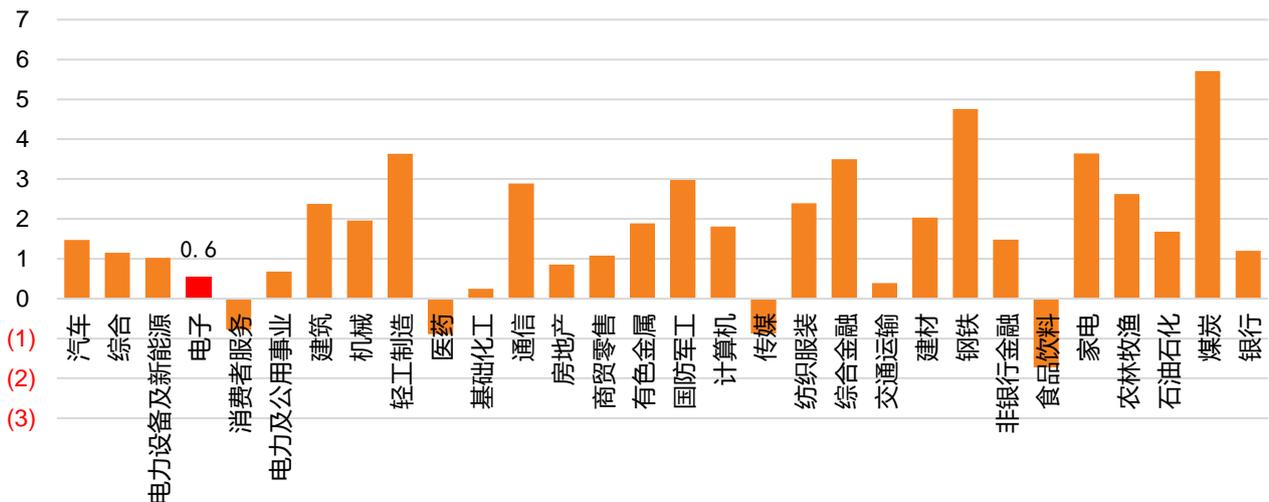
本周半导体行情跑输部分主要指数。本周申万半导体行业指数下跌 0.13%，同期创业板指数下跌 0.83%，上证综指上涨 1.34%，深证综指上涨 0.61%，中小板指上涨 0.45%，万得全 A 上涨 0.98%。半导体行业指数跑输部分主要指数。

表 5: 本周半导体行情与主要指数对比

	本周涨跌幅%	半导体行业相对涨跌幅 (%)
创业板指数	-0.83	0.70
上证综合指数	1.34	-1.47
深证综合指数	0.61	-0.74
中小板指数	0.45	-0.57
万得全 A	0.98	-1.11
半导体 (申万)	-0.13	-

资料来源: Wind, 天风证券研究所

图 8: 本周 A 股各行业行情对比 (%)



资料来源: Wind, 天风证券研究所

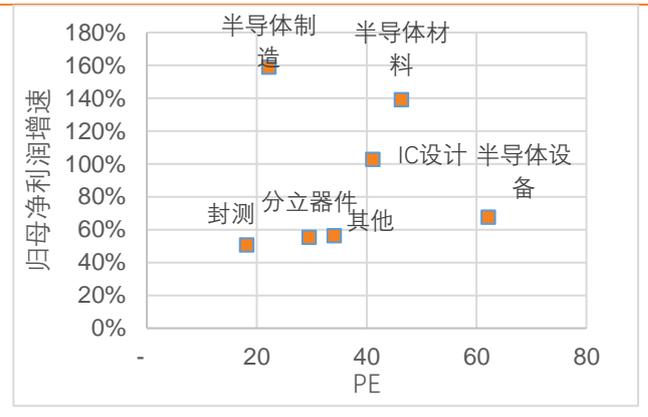
半导体各细分板块跌多涨少。半导体细分板块中，半导体制造板块本周下跌 1.1%，半导体设备板块本周下跌 0.5%，分立器件板块本周下跌 1.3%，半导体材料板块本周上涨 0.6%，IC 设计板块本周下跌 1.3%，封测板块本周下跌 0.02%，其他板块本周下跌 1.0%。

图 9: 本周子板块涨跌幅 (%)

图 10: 半导体子板块估值与业绩增速预期



资料来源: Wind, 天风证券研究所



资料来源: Wind, 天风证券研究所

本周半导体板块涨幅前 10 的个股为: 通富微电、炬光科技、寒武纪-U、复旦微电、海光信息、龙芯中科、博通集成、必易微、富满微、芯原股份-U

本周半导体板块跌幅前 10 的个股为: 敏芯股份、恒玄科技、唯捷创芯-U、路维光电、国芯科技、澜起科技、长川科技、圣邦股份、力芯微、瑞芯微

表 6: 本周涨跌前 10 半导体个股

本周涨幅前 10	涨跌幅 (%)	本周跌幅前 10	涨跌幅 (%)
通富微电	14.78	敏芯股份	-7.42
炬光科技	14.59	恒玄科技	-6.06
寒武纪-U	9.91	唯捷创芯-U	-5.54
复旦微电	8.26	路维光电	-4.93
海光信息	7.43	国芯科技	-4.57
龙芯中科	5.82	澜起科技	-4.46
博通集成	5.23	长川科技	-3.39
必易微	5.02	圣邦股份	-3.27
富满微	5.01	力芯微	-3.26
芯原股份-U	4.58	瑞芯微	-3.15

资料来源: Wind, 天风证券研究所

3. 本周重点公司公告 半导体公司公告

【华润微 688396.SH】

公司于 2023 年 2 月 25 日公告《2022 年度业绩快报公告》。公告显示, 2022 年度, 公司实现营业收入 1,006,012.95 万元, 较上年同期增长 8.77%; 营业利润 251,015.09 万元, 较上年同期增长 6.78%; 利润总额 265,435.31 万元, 较上年同期增长 12.75%; 归属于母公司所有者的净利润 261,967.05 万元, 较上年同期增长 15.51%; 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 222,868.00 万元, 较上年同期增长 6.20%; 基本每股收益 1.9845 元, 较上年同期增长 12.47%。2022 年度, 疫情形势复杂, 市场环境严峻, 公司积极落实各项应对措施, 充分发挥 IDM 模式优势, 积极开拓市场, 加速产品结构的优化, 加大研发投入, 不断提升核心技术能力, 保持了较高的产能利用率, 整体经营业绩稳步提升。

【卓胜微 300782.SZ】

公司于 2023 年 2 月 24 日公告《2022 年度业绩快报》。公告显示, 2022 年公司实现营业总收入 367,933.81 万元, 较上年同期下降 20.59%; 营业利润 107,555.24 万元, 较上年同期下降 51.58%; 利润总额 106,840.58 万元, 较上年同期下降 55.76%; 归属于上市公司股东的净利润 107,578.38 万元, 较上年同期下降 49.61%; 扣除非经常性损益

后的归属于上市公司股东的净利润 107,123.16 万元，较上年同期下降 44.74%。

【艾为电子 688798.SH】

公司于 2023 年 2 月 25 日公告《关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告》。公告显示，截至 2023 年 2 月 24 日，孙洪军先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持本公司股份 45,000 股，占公司股本总数的 0.0271%，合计增持金额为人民币 464.27 万元。目前，孙洪军先生直接持有公司股份 69,605,997 股，合计占公司总股本的 41.93%。本次增持计划已实施完毕。

【乐鑫科技 688018.SH】

公司于 2023 年 2 月 25 日公告《2022 年年度业绩快报公告》。公告显示，2022 年度，公司实现营业收入 127,112.72 万元，同比减少 8.31%；营业利润 8,612.26 万元，同比减少 58.67%；利润总额 8,608.77 万元，同比减少 58.68%；归属于母公司所有者的净利润 9,732.31 万元，同比减少 50.95%。扣除结构性存款收益、政府补助等影响，报告期内实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,665.28 万元，同比减少 61.41%。

4. 本周半导体重点新闻

中芯国际天津西青 12 英寸项目预计 3 月中旬完成桩基施工作业。近日，中芯西青 12 英寸晶圆代工生产线项目传来新进展。中建二局二公司消息显示，目前，该项目正全力进行 P1 生产厂房、CUB 动力中心、生产辅助厂房桩基施工，预计 3 月中旬完成桩基施工作业。中芯国际天津西青 12 英寸芯片项目于 2022 年 9 月开工。当时消息显示，该项目计划投资 75 亿美元，规划建设月产能为 10 万片的 12 英寸晶圆生产线，可提供 0.18 微米~28 纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务，产品主要应用于通讯、汽车电子、消费电子、工业等领域。(icspec)

总投资 20 亿元，达新电子 6 英寸 IGBT 功率半导体生产线项目开工。2 月 18 日，重庆涪陵区举行 2023 年一季度重点项目集中开竣工仪式。涪陵发布消息显示，集中开竣工项目共 45 个，总投资 252.5 亿元。其中，集中开工项目包括达新电子 6 英寸 IGBT 功率半导体生产线项目。达新电子 6 英寸 IGBT 功率半导体生产线项目总投资 20 亿元，建设一条年产 120 万片 6 英寸功率半导体特色工艺晶圆产线，产品应用将覆盖新能源汽车、智能电网、光代储能、风力发电、工业应用、白色家电等领域，将建成国内领先的投资少、见效快、低成本、高品质的特色工艺晶圆产线。(eet-china)

5. 风险提示：

疫情继续恶化、上游供给不足、科研进度不及预期、需求不及预期

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100031	A 栋 23 层 2301 房	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	邮编：570102	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	电话：(0898)-65365390	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com